

中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（申报稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司 64.69%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 4 月 24 日收到上海证券交易所出具的《关于受理中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》【上证科审（并购重组）[2026]17 号】，并于 2026 年 4 月 25 日披露了《中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（申报稿）》（以下简称“报告书（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关文件。

相较于 2026 年 3 月 31 日披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，报告书（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

重组报告书章节	修订情况说明
重大事项提示	更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况。
重大风险提示	1、更新了本次交易的决策过程和审批情况； 2、对部分风险提示进行了更新和补充。
第一节 本次交易概况	1、对差异化定价的原因、未一次性收购管理团队全部股权的主要考虑等进行了更新和补充； 2、对本次交易相关方作出的重要承诺等进行了更新和补充。
第三节 交易对方基本情况	1、补充了交易对方是否构成一致行动关系及认定依据的说明； 2、补充了交易对方中员工持股平台的情况。
第四节 交易标的基本情况	1、对标的公司历史沿革进行了补充披露； 2、补充披露标的公司与股东签署的特殊权利条款及其终止情况；

重组报告书章节	修订情况说明
	3、对标的公司主要经营模式进行了更新和补充； 4、对标的公司主要原材料采购情况进行了更新和补充。
第八节 本次交易的合规性分析	补充了本次交易符合《重大资产重组审核规则》第四十五条、第五十七条、第五十八条的相关规定。
第九节 管理层讨论与分析	补充收入增长可持续性、季节性、经营活动现金流分析。
第十二节 风险因素	1、更新了本次交易的决策过程和审批情况； 2、对部分风险提示进行了更新和补充。
第十三节 其他重要事项	补充了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026年4月25日